



BOLIX UZB

Wzbogacony mikrowłóknami biały klej do systemów ociepleń /do płyt styropianowych/

■ ZASTOSOWANIE:

Służy do przyklejania płyt styropianowych do typowych podłoży mineralnych i wykonywania na styropianie warstwy zbrojonej odpowiednią siatką z włókna szklanego. Właściwości wyrobu pozwalają na aplikację w obniżonych zakresach temperatury otoczenia tj. od $+3^{\circ}\text{C}$, a po upływie 8 godz. od czasu nałożenia możliwe spadki temp. do -5°C . Wykazują wysoką przyczepność oraz elastyczność do podłoża, a poprzez zastosowanie mikrowłókien jest odporna na zarysowania i pęknięcia. Stosowany jest przy docieplaniu ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń oraz przy naprawach i renowacjach ścian zewnętrznych budynków ocieplonych według metody „lekkiej mokrej”. Jest używany również do wyrównywania /nierówności do 5 mm/ i wygładzania podłoży mineralnych przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych.

■ TECHNOLOGIA WYKONANIA:

■ Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować preparatem BOLIX T. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską BOLIX W. Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym BOLIX T. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. $10 \times 10 \text{ cm}$) i ręcznego ich odrywania po min. 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym BOLIX N i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu BOLIX N i BOLIX T wynosi min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza $+20^{\circ}\text{C}$).

■ Przygotowanie produktu:

Zawartość opakowania wysypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody ($5,25 \div 5,75$ litra) i dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej

konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W zależności od temp. i wilgotności powietrza przygotowana zaprawa jest przydatna do użycia przez ok. 1,5 h. Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy wymagają temperatury w przedziale od $+3^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$ (dotyczy również temp. podłoża).

■ Zastosowanie produktu:

I) Przyklejanie styropianu:

Przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę styropianową metodą „pasmowo-punktową”, czyli pasmami o szer. ok. 3-6 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od krawędzi płaszczyzny płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi „plackami” w ilości od 8-10 szt. o średnicy 8-10 cm. Prawdopodobnie nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Styropian przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy (w temp. od $+3^{\circ}\text{C}$ do $+5^{\circ}\text{C}$ po min. 72 h, a w temp. powyżej $+5^{\circ}\text{C}$ po min. 48 h) przyklejone płyty można zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. Po czym, przeszlifować całą licową powierzchnię zamocowanych płyt pacą z grubym papierem ściernym.

II) Wykonanie warstwy zbrojonej:

Na powierzchni odpylonej po szlifowaniu płyt styropianowych należy wykonać (w temp. od $+3^{\circ}\text{C}$ do $+5^{\circ}\text{C}$ nie wcześniej niż po min. 72 h, a w temp. powyżej $+5^{\circ}\text{C}$ nie wcześniej niż po min. 48 h) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać /w pionie i w poziomie/ na zakład nie mniejszy niż 10 cm. W przypadku pozostawienia nierówności na wyschniętej powierzchni przyklejonej siatki nanieść drugą ciekłą warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm.

■ Zalecenia wykonawcze:

- Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie zaprawy klejącej dopiero po jego wyschnięciu, czyli po upływie ok. 3-4 tygodni.



BOLIX UZB

Wzbogacony mikrowłóknami biały klej do systemów ociepleń /do płyt styropianowych/

- Przy klejeniu styropianu na chłonnych podłożach mineralnych, należy wcześniej zagruntować te podłoża preparatem BOLIX T.
- Gruntowanie można wykonać jedynie na powierzchni wyschniętej, dopiero po upływie właściwego dla danego podłoża okresu wiązania i twardnienia.
- Należy odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne).
- Proces przygotowania, przyklejenia i wiązania zaprawy klejącej powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temp. powietrza od $+3^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$.
- Zaprawę klejącą należy nakładać na podłoża o temp. od $+3^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$.
- Warstwy zbrojonej nie należy wykonywać podczas opadów deszczu oraz na powierzchniach narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca lub wiatru.
- Dopuszcza się spadek temperatury do -5°C po upływie 8 godzin od czasu nałożenia zaprawy.
- Podczas realizacji robót ociepleniowych, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych.
- Jeżeli na styropianie przymocowanym do podłoża nie zostanie wykonana w ciągu 2 tygodni warstwa zbrojona, to należy ocenić jakość zewnętrznej warstwy styropianu. Płyty o pożółkłej i pylącej powierzchni trzeba przed nakładaniem zaprawy klejącej, ponownie przeszlifować.
- Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej $+3^{\circ}\text{C}$ przez co najmniej 8h od momentu nałożenia zaprawy. (dopuszczalny spadek temperatury do -5°C po upływie powyższego czasu) do czasu związania.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania kleju.
- Należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu (profile dylatacyjne) dylatacji występujących w podłożu.
- Po zakończeniu nakładania zaprawy klejącej narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu kleju czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.

- Wzbogacony mikrowłóknami biały klej BOLIX UZB jest elementem systemów ociepleń BOLIX oraz systemu renowacji elewacji BOLIX RENO-TERM.
- Pełna i gwarantowana skuteczność tego materiału ma miejsce wówczas, gdy jest on stosowany razem z pozostałymi elementami systemu, zgodnie z technologią wykonania (opisaną w Instrukcjach BOLIX Nr IB/01/2001 oraz BOLIX Nr IB/05/2005).

Środki ostrożności:

Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

Wskazówki dodatkowe:

W celu prawidłowego zastosowania produktu przy wykonywaniu ocieplenia zalecamy zapoznać się z treścią Instrukcji BOLIX Nr IB/01/2001 - "Docieplenie ścian zewnętrznych budynków". W celu prawidłowego zastosowania produktu przy naprawie elewacji zalecamy zapoznać się z treścią Instrukcji BOLIX Nr IB/05/2005 - "Naprawa ścian zewnętrznych budynków w systemie BOLIX RENO-TERM".

Niezbędne narzędzia:

- Wiadro budowlane
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa ($400 \div 500 \text{ obr/min}$) z mieszadłem koszykowym
- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
- Duża paca ze stali nierdzewnej
- Mała paca ze stali nierdzewnej
- Wiertarka udarowa
- Młotek budowlany
- Paca z gruboziarnistym papierem ściernym

DANE TECHNICZNE:

Parametry użytkowe zaprawy klejącej:

- Temperatura stosowania: od $+3^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$
- Temperatura podłoża: od $+3^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$
- Proporcje mieszania: 5,25-5,75l wody na 25 kg kleju
- Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h
- Spływ: $< 0,12 \text{ mm}$
- Przyczepność:
 - przyczepność do betonu: $> 0,6 \text{ MPa}$
 - do styropianu: $> 0,1 \text{ MPa}$ (rozerwanie w warstwie styropianu)



BOLIX UZB

**Wzbogacony mikrowłóknami biały klej
do systemów ociepleń /do płyt styropianowych/**

■ Dane techniczne i własności produktu:

- Konsystencja: suchy proszek
- Kolor: biały
- Gęstość nasypowa: ok. 1,50 kg/dm³

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza +20°C/

■ ZUŻYCIE:

- Zużycie zaprawy klejącej przy wykonywaniu ocieplenia budynku:
- przy klejeniu płyt styropianowych na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi ok. 4,0 kg/m²
- przy wykonywaniu warstwy zbrojonej wynosi ok. 4,0 kg/m².

Przy szpachlowaniu podłoża zaprawą klejącą BOLIX UZB jej zużycie zależy od grubości wytworzonej warstwy i wynosi średnio 1,3 kg/m² (suchego kleju) na każdy 1 mm grubości warstwy. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu na danym podłożu zaleca się przeprowadzenie odpowiednich prób.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temp. od +5°C do +25°C. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

- Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2693/2005.
- Certyfikat nr ITB/003. Jednostka certyfikująca Instytut Techniki Budowlanej AC 020.
- Deklaracja zgodności nr 2/1/B/2005 z dn. 30.05.2005.

■ SKŁAD:

Klej BOLIX UZB jest suchą mieszanką spoiw hydraulicznych, polimerów, bazy drobnziarnistych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

Bolix S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec
tel. / + 48 33/ 475 06 00, fax./ + 48 33/ 475 06 12

www.bolix.pl

data aktualizacji: 2006-09-08